

## SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



### Der durchgängige Tragschienenbus für das modulare Elektronikgehäuse-System

Beim Versorgen, Verbinden und Verteilen in modularen Applikationen ersetzt der Tragschienenbus die aufwändige Einzelverdrahtung durch eine unterbrechnungsfreie und flexible Systemlösung. Der Systembus ist sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert. Per Reflow-Verfahren lässt sich der SMD-Bus-Kontaktblock bei der Baugruppenfertigung vollautomatisch verarbeiten. Die widerstandsfähigen, vergoldeten Kontaktflächen gewährleisten eine dauerhaft zuverlässige Kontaktierung für alle Gehäusebreiten.

- **Grenzenlose Skalierbarkeit** - die durchgängige Verbindungslösung quer über alle Systembaubreiten - von der 6 mm-Scheibe bis zum 67 mm-Großraumgehäuse.
- **Servicefreundliche Installation** - einfacher Modulwechsel auch im bestehenden Modulverbund ohne Auswirkung auf benachbarte Module.
- **Universelle Integration** - unterbrechnungsfreier Systembus: sicher in die 35mm-Standard-Tragschiene integriert.
- **Maximale Verfügbarkeit** - Fünf voll-galvanisierte und teil-vergoldete Twinbogenkontakte stellen eine dauerhafte Kontaktierung zum Tragschienenbus sicher. THR-Lötflansche sorgen für eine stabile Verbindung zur Leiterplatte.

### Allgemeine Bestelldaten

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67, Mittellötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, vergoldet, schwarz |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1155880000</a>  |
| Typ                | SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK RL  |
| GTIN (EAN)         | 4032248942305   |
| VPE                | 300 Stück   |
| Produkt-Kennzahlen | UL:   |
| Verpackung         | Tape  |

## SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Höhe         | 5,9 mm  | Höhe (inch)   | 0,232 inch |
| Breite       | 16,3 mm | Breite (inch) | 0,642 inch |
| Länge        | 24 mm   | Länge (inch)  | 0,945 inch |
| Nettogewicht | 3,38 g  |               |            |

### Temperaturen

|                          |        |                          |        |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur, min. | -50 °C | Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
|--------------------------|--------|--------------------------|--------|

### Werkstoffdaten

|                             |                 |                    |      |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------|
| Isolierstoff                | LCP             | Isolierstoffgruppe | IIIa |
| Kriechstromfestigkeit (CTI) | 175 ≤ CTI < 400 |                    |      |

### Bemessungsdaten nach IEC

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| geprüft nach Norm | IEC 60664-1, IEC 61984 |
|-------------------|------------------------|

### Allgemeine Daten

|           |         |                       |          |
|-----------|---------|-----------------------|----------|
| Farbe     | schwarz | Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
| Schutzart | IP20    |                       |          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ETIM 8.0    | EC001031    | ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |

### Wichtiger Hinweis

|                 |  |
|-----------------|--|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
|-----------------|--|

### Zulassungen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Zulassungen            |  |
| ROHS                   | Konform   |
| UL File Number Search  | UL Webseite   |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693  |

## SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                   |   |
|-------------------|---|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Broschüren        | <a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |

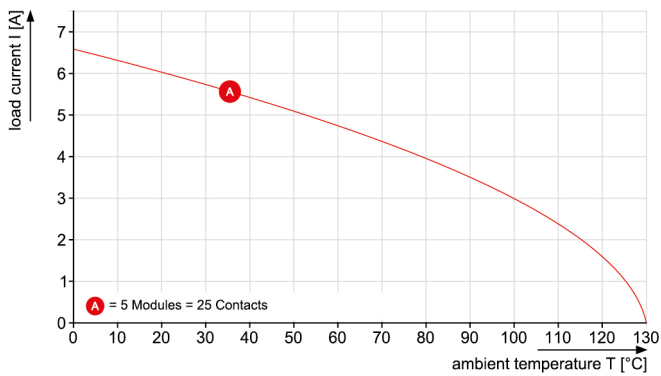
## SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

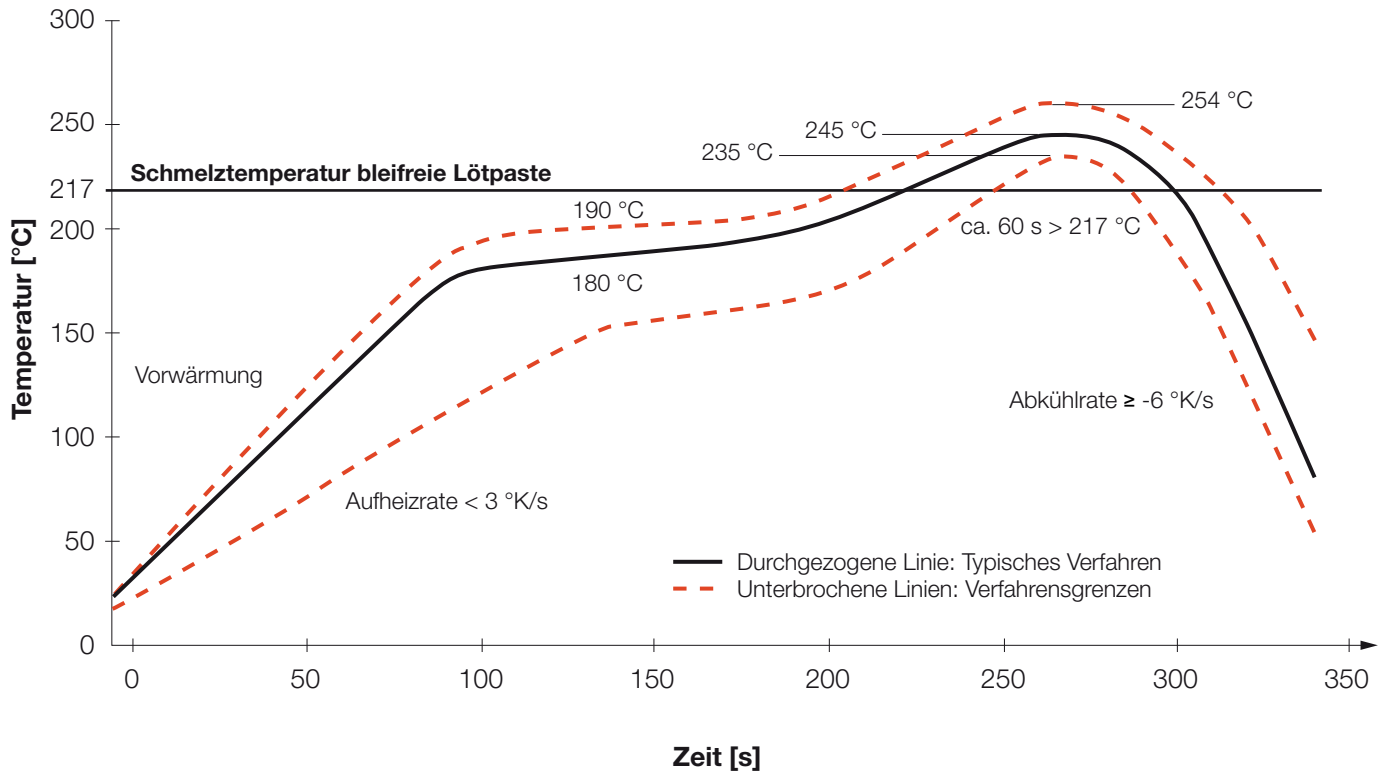
# Zeichnungen

CH20M22-Bus



## Empfohlenes Reflow-Lötprofil

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Reflow Lötprofil

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt  $\leq +3$  K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste ‚aktiviert‘. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüssen auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei  $\geq -6$  K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.